

CIRCUITI STAMPATI IN BASE ALLUMINIO IN BASE RAME



PER TUTTE LE APPLICAZIONI CHE NECESSITANO
DI UN'ELEVATA DISSIPAZIONE DEL CALORE

Materiali

CEM3 High Thermal

Materiali IMS

Substrato: alluminio, rame

Dielettrico: ceramico, fillerato

Rame: 35, 70, 105 μm

Materiali in alluminio/dielettrico
flessibile con rame duttile

Spessore supporto

0,3 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 3,0 mm

Spessore rame

35-70-105 μm

Trattamenti

Foratura: CNC-Tranciatura

Solder resist: UV e Fotografico (con
pigmentazioni anti ingiallimento del
bianco) Serigrafia

Finiture meccaniche

Fresatura, Scoring+Jump,
Tranciatura, Svasatura fori

Finiture superficiali

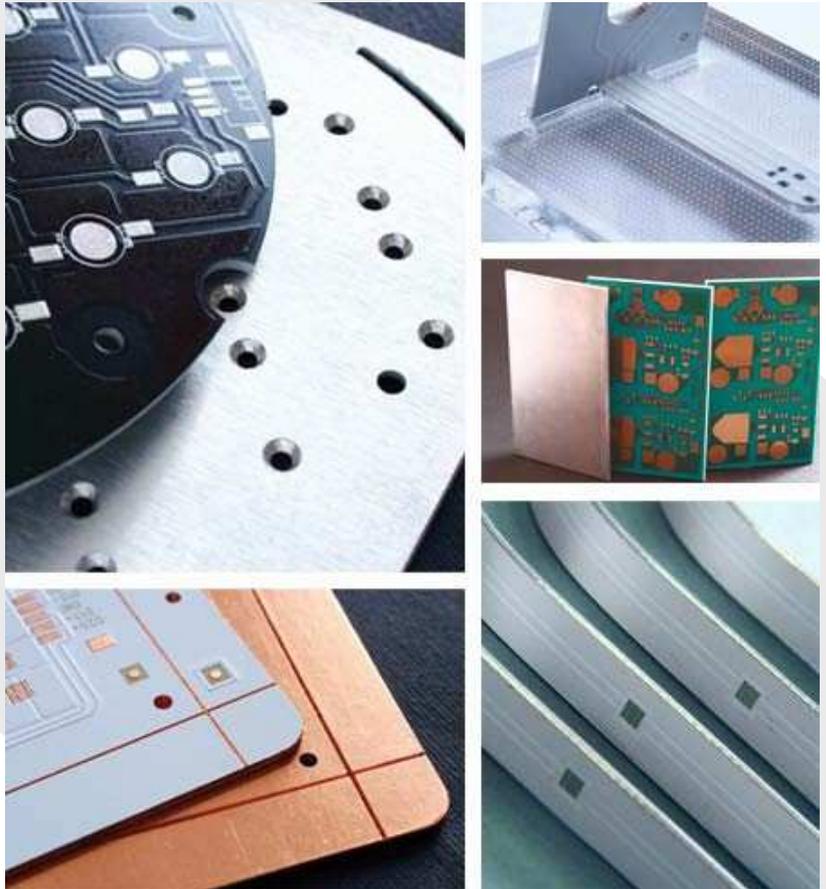
Hal, Rame passivato

Test elettrico

Bassa e alta tensione, Test ottico con AOI

Omologazioni

UL FILE :e173328



SITEL

Via dell'Artigianato, 6 | 31030 | Dosson di Casier (Treviso) | Tel. 0422 380950 |

info@sitelpcb.it | www.sitelpcb.it